

证券代码：301338

证券简称：凯格精机

东莞市凯格精机股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-003

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u> 电话会议 </u>
参与单位名称及人员姓名	国海证券、凯石投研、正圆投资、趣时资产、紫阁投资、汇添富基金、中泰证券
时间	2023年05月10日 15:00-16:00 2023年05月11日 10:00-11:00 2023年05月12日 10:00-11:00
地点	公司会议室现场会议、电话会议
上市公司接待人员姓名	董秘邱靖琳、证券事务代表刘丹
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、2023年第一季度收入下滑的主要原因？</p> <p>答：2022年，受全球范围内宏观经济增长乏力，特别是下半年国际地缘政治变动带来的全球贸易格局的重大变化，全球消费电子、光电显示、网络通信等市场需求同比2021年明显下降。公司总体销售业绩虽不及预期，在公司四个设备事业部的共同努力下，顶住了市场疲软的压力，销售收入基本保持持平的同时实现了净利润增长。2022年度净利润指标创新高。</p> <p>2022年，公司继续落实新产品的研发计划，并取得丰硕</p>

研发成果。除在传统表面贴装市场推出多款迭代新产品机型外，面向半导体、新能源及汽车电子等新领域的新产品研发也进展顺利。2022年下半年，公司在半导体的应用领域推出包括高精度固晶机、高精度印刷机以及植球机等多款新产品。在LED行业，公司推出MiniLED固晶机、COB柔性灯带自动化生产整线等行业新产品。公司柔性自动化事业部，也在现有产品系列上，从高通用性、高精度性、高兼容性、高稳定性等方面完善、延展多款新产品及工艺解决方案。依托研发中心作为技术与产品的孵化、赋能平台，公司逐步形成了“多产品+多领域”的研发布局。

近年来，公共事件的发生导致居家办公、远程教育等在线需求提升，消费电子出货量爆发式增长，提前透支了未来需求。2022年消费电子市场回归平静，需求放缓，目前行业仍处于去库存阶段，加上全球经济下行，消费意愿和下游扩产意愿放缓，专用设备需求不如预期，给公司2023年一季度业绩带来了一定压力。

虽然公司2023年第一季度业绩受到了市场行情的影响，但我们在电子装联行业的实力和市场地位仍然是稳固的。我们始终相信并坚持公司的发展战略，依托七大共性技术模块研发体系和高效的矩阵式产品孵化管理体系，做好新产品的迭代更新，加大半导体、系统级封装领域的植球设备、固晶设备、点胶设备等产品的研发投入。实现从单项冠军到多项冠军的跨越，最终成为最具竞争力的精密自动化装备和服务提供商。

2、目前整体设备的在手订单情况如何？

答：公司目前在手订单情况稳定，生产经营一切正常。

3、柔性自动化设备今年订单以及收入的展望？

答：公司柔性自动化事业部 2022 年度实现了 295.71% 的增长，在宏观环境不太好的情况下，市场表现出下游客户倾向于选择自动化设备提高产出效率与效能的趋势；

公司柔性自动化设备 2018 年开始实现销售，承接了多项电子装联及组装项目，对于客户提出的不同的工艺、模块搭配、整线交付等需求有丰富经验积累，特别是对于新能源汽车应用领域。得益于深厚精密自动化设备 know-how，公司在各类自动化设备产线项目中总结了标准化工艺解决方案。针对客户来自于相似应用领域的需求，自动化部门可以从过往案例中选用匹配的设计方式进行复用和升级，方案落地能力和响应能力得到快速提高。

今年公司柔性自动化项目会聚焦于推广柔性自动化的标准品，应用领域以新能源汽车及电子领域为主。

4、如何看待 Mini LED 的发展趋势？

答：根据第三方报告，由于行业尚处于发展初期，产品规格暂未形成标准。目前判断，整个产业需要呈现大规模增长时，确定了通用标准产品方案，且每个产品的各档位被合理化利用时，才能实现芯片降本。GGII 预计，2025 年全球 Mini LED 市场规模将达到 53 亿美元，复合增长率将超过 85%。目前我们也看到一些市场上的龙头企业在加速布局 Mini LED 产线，今年 Mini LED 市场规模或迎来快速发展。

5、半导体设备目前的进展？

答：高密度封装技术与 SMT、SMT 与 PCB 制造技术相

	<p>结合的新型模块化组件、系统化组件具有体积明显缩小，提高频率特性和散热性，提高可靠性，增加电子产品的使用寿命，提高 SMT 生产效率等优点。SMT 技术逐渐被半导体厂商应用，传统的技术区域界限日趋模糊，半导体封装与 SMT 的融合已成为趋势。</p> <p>半导体行业的供应链正在重构，相对封闭的体系正在被逐渐打破。具有 SMT 经验的公司所独具的快速迭代能力、成本控制意识，能够更好地助力半导体厂商在新产品、新技术上的推广和应用。</p> <p>公司针对半导体行业推出的新产品有：</p> <p>全自动晶圆植球整线(Climber-SL200):为 4/6/8/12 英寸晶圆级印刷植球，印刷植球一体化，150um 级球径漏球率 ≤0.01%，应用领域高进先进封装、存储器、逻辑器件、封装器件应用等领域；</p> <p>半导体全自动高精贴装机（DX5+GD212S）：精密 Dispensing+高精 DieBond 整线，包括单台或多台精密点胶机（DX5）+单台或多台半导体全自动高精贴装固晶机（GD212S)+其它分立元器件贴装机,贴装精度 ±10um、贴装角度 ±1°，应用于半导体领域、集成电路、消费电子、通信系统、封装器件，可实现系统级封装的应用领域等。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 5 月 22 日